

证券代码：688598

证券简称：金博股份

湖南金博碳素股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	安信证券化工分析师张汪强
时间	2020年6月10日10:00
会议地点	金博股份会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：王冰泉先生 董事会秘书：童宇女士 证券事务代表：罗建伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就业务开展情况、未来发展战略、行业竞争优势、经营模式等内容做了介绍，并回答了投资者相关问题。</p> <p>1、公司募投产能是多少？何时会达产？</p> <p>答：募投产能约200吨左右，建设期为二年左右，公司前期以自有资金投入，预计会按时或提前达产。</p> <p>2、公司目前市占率？未来目标市占率？</p> <p>答：由于未有权威机构针对该细分行业产品的需求、市场占有率的统计，计算产品的需求和市场占有率可将坩埚、导流筒折算为单晶拉制炉炉台数，再将炉台数折算为单晶硅片的出货量，计算其占全球光伏用单晶硅片的出货量的比例，从而推算出公司目前产品的市占率，现约为30%左右。公司将根据项目建设、市</p>

	<p>场情况、竞争对手情况来拟定市占率目标，进一步提高市占率。</p> <p>3、公司产品未来应用领域市场空间较大的有哪些行业？</p> <p>答：公司以先进碳基复合材料全产业链低成本制备核心技术为基础，进行相关领域产品的多元化开发和市场拓展，积极布局真空热处理领域、密封耐磨领域、化工耐腐蚀领域等与先进碳基复合材料相关的市场。</p> <p>4、请比较光伏行业和半导体行业对公司产品的需求？</p> <p>答：半导体领域对于热场系统材料部件的纯度要求较光伏领域略高，除此之外，其他生产标准、技术门槛不存在差异。随着国家加大对半导体行业的投入和大硅片国产化进程的加快，公司产品在半导体领域的应用预计将会得到快速发展，并能够为国产大硅片提供高性能、国产化热场部件的关键技术和产品支撑。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年6月10日